



2022年6月14日

各 位

会社名 インスペック株式会社
代表取締役社長兼 菅原 雅史
代表執行役員
(コード番号：6656 東証スタンダード)
問合せ先 取締役兼執行役員 佐藤 真
管理統括部長
TEL 0187-54-1888 (代表)

中期経営計画策定に関するお知らせ

当社は、2025年4月期を最終決算期とする中期経営計画（2023年4月期～2025年4月期）を新たに策定いたしましたので、お知らせいたします。

詳細につきましては、添付資料をご参照ください。

以上

インスペック株式会社

中期経営計画

2022年6月14日

インスペック株式会社



JQA-QMA16212



MS
CM009



(証券コード：6656)

inspec

1. 中期経営計画について

2. 売上・利益計画

3. 製品・サービス戦略

4. 海外事業展開

5. 企業文化・風土改革

インスペック株式会社

inspec

～ 2022年4月期

2023年4月期 ～ 2025年4月期

2026年4月期～

「インスペック2.0」

既存事業と新事業による成長の
持続と安定した財務体質を実現し、
次のステージへ

- 検査装置、露光装置の新製品開発・販売
- パーパスを策定し全社員一丸となって前進
- アジアへの進出拡大
- 地域貢献と雇用の創出

「創成期」

検査装置事業の核を作り上げ
経営基盤の基礎を築いた時期

「飛躍」

東証プライム市場上場を目指し
更なる高みへ



1. 中期経営計画について

2. 売上・利益計画

3. 製品・サービス戦略

4. 海外事業展開

5. 企業文化・風土改革

2025年4月期

- **売上高成長率** 20%以上
- **営業利益率** 15%以上
- **海外売上比率** 50%以上
- **自己資本比率** 35%以上

■利益計画

(単位：百万円)

	2023年4月期 計画	2022年4月期 実績	前期比増減	増減率
売上高	2,250	1,762	488	+27%
営業利益 / 率	100 / 4.4%	18 / 1.0%	82	+429%
経常利益	90	132	△ 42	△ 32%
当期純利益	70	155	△ 85	△ 55%

inspec Inc.

CL2D PCB

Rev.2

K-22

1. 中期経営計画について

2. 売上・利益計画

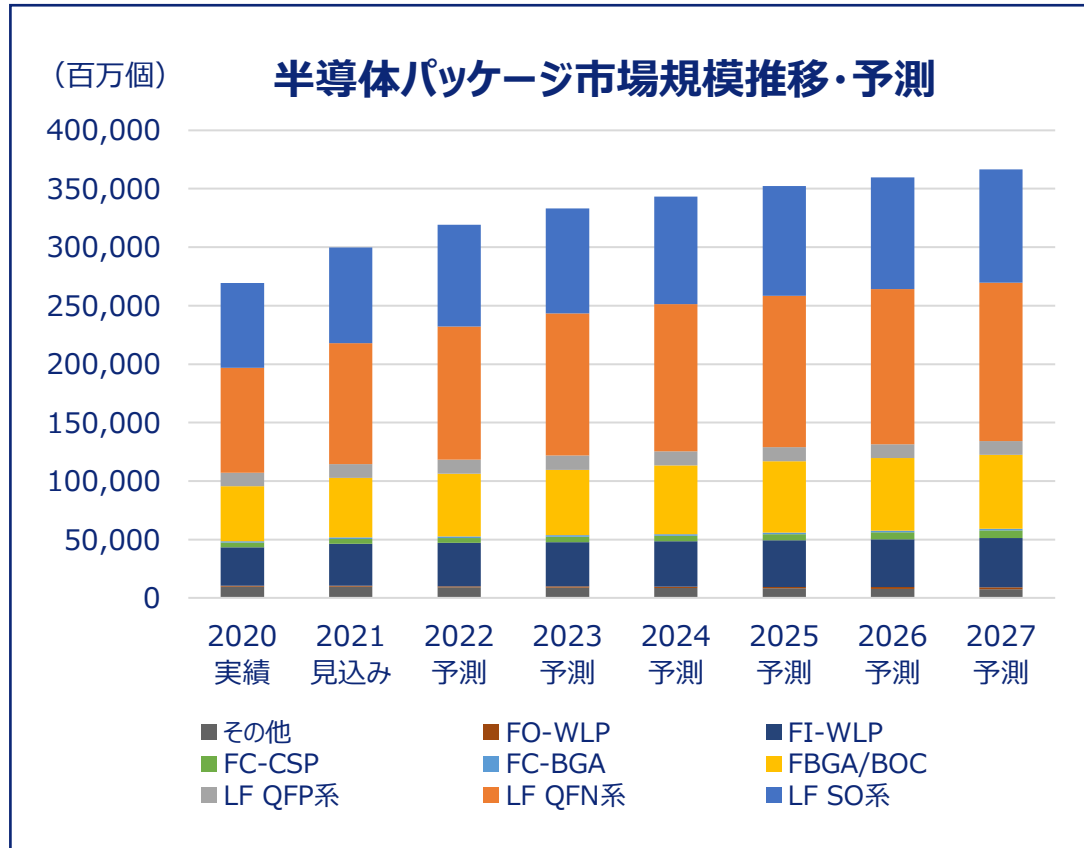
3. 製品・サービス戦略

4. 海外事業展開

5. 企業文化・風土改革

検査装置のイノベーション

半導体関連産業の好調が続いており、パッケージ基板の検査需要が高まっている中、より広く当社のAOIを使っていただけるようラインナップを刷新し、従来よりも使いやすく高速、高性能なAOIをよりリーズナブルに提供します。



2021年 富士キメラ総研

■ 全体市場

- 2021年には、巣ごもり需要やリモート需要でPCを中心とした情報通信機器向けが非常に好調であったことに加え、2020年に市場が落ち込んだ自動車、スマートフォン関連市場が回復したことで、前年比11.3%増と見込まれる。金額ベースでは更に高い成長率となる。
- 2021年は、28nmや40nmプロセスを採用したドライバーICやマイコンなどで、供給不足の状態が続いている。ファウンダリーが立ち上がりこれらの生産が進むことで、2022年は前年比6%増と予測した。その後も3%前後の成長が続くと見られる。

2021年 富士キメラ総研



SX5600

半導体パッケージ基板向けAOI『SX5600』

- インスペック基板AOIのフラッグシップモデル
- 最先端の超高精細基板に対応
- クラス最速レベルの生産性を実現

半導体パッケージ基板向けAVI『BP7200』

- JEDECTレイをまるごと検査
- クラス最高レベルの超高速検査を実現
- CPU向けパッケージ基板で多くの実績
- 全自動検査 + 全自動良品/不良品振り分け



BP7200

■ 常に最先端の製品に対応し業界をリードします

① 超高精細検査

ニーズを先取りし、微細化が進む最先端のハイエンドパッケージ基板に対応し続けます。

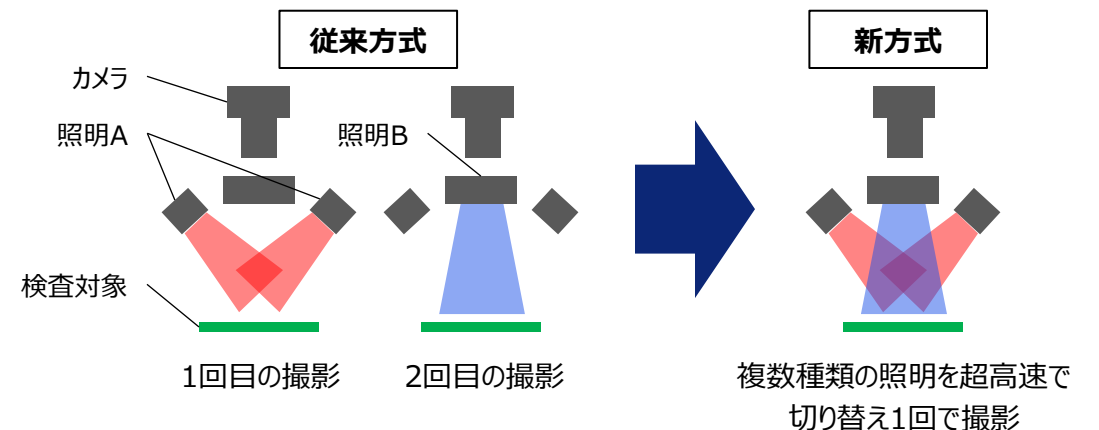


② レーザービア測長検査

ニーズが急拡大しているあらゆるタイプのレーザービア検査に対応しています。
全てのビアの径、形状、位置ずれを測定し、他工程へフィードバックすることができます。

③ 『Tachyon (タキオン)』 超高速スイッチング照明システム

『Tachyon』では、右図の照明Aと照明Bを超高速で交互に点滅させることで、複数の画像を一度のスキャンで撮影し、検査タクトの大幅な短縮を実現します。



露光装置事業

加速する自動車の電子化、電動化により、車載FPCの需要が急拡大しています。インスペックはこの車載FPCをシームレスに、そして高速に露光できる露光装置をリーズナブルに提供します。

■ ロールtoロール型シームレス直描露光装置『RD3050』



RD3050

- インспекの**戦略的新製品**
- NEW** 500mmまでの幅広FPCに対応（RD3000は幅250mmまで対応）
- 露光単位ごとに搬送を止めない**ノンストップ露光**で**生産性アップ**
- ピース単位で個別2次元コードを付与し、トレーサビリティや他工程へのフィードバックが容易に
- 低消費電力でCO2排出削減に貢献



■ 販売に向けた取り組み

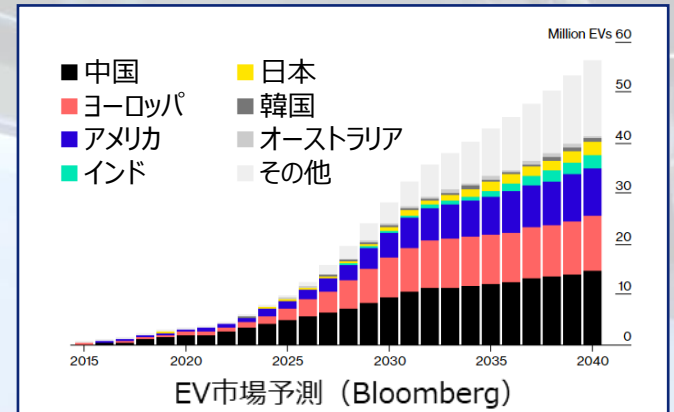
- 複数のFPC関連メーカー様と連携し、装置導入に向けた評価を実施中です。
- 海外への販売活動を開始しています。
- 国内外の各種展示会に出展します。



RD3000シリーズで露光したFPC

急成長するEV市場向け製品

今世界ではEVの市場が急成長する中、車載FPCの需要が拡大しています。インスペックでは、この車載FPCに特化したロールtoロール型シームレス直描露光装置『RD3000シリーズ』及びロールtoロールAOI『RA7400』をラインナップすることで、拡大する市場のニーズに素早くお応えします。



RD3050

ロールtoロール型シームレス直描露光装置『RD3000シリーズ』

- 車載FPCに最適なスペックを**低価格、低ランニングコスト**で提供
- NEW** 500mmの幅広FPCに対応

車載分野向けロールtoロールAOI『RA7400』

- **超高速検査**で圧倒的な生産性を実現
- **車載向け長尺FPC**に特化したモデル
- 充実したスペックを**低価格**で提供



RA7400

2023年4月期

2024年4月期

2025年4月期

超高速スイッチング
照明システム『Tachyon』開発

微細化が進む次世代半導体パッケージ基板向けAOIで
トップランナーに

車載向けAOI
RA7400出荷


車載向けロールtoロール型検査装置のグローバル展開

RtoR露光装置
RD3000評価

ロールtoロール型露光装置RD3000シリーズのグローバル展開

次世代ロールtoロール型直描露光装置開発（NEDO）

▲新露光装置販売開始

- 
1. 中期経営計画について
 2. 売上・利益計画
 3. 製品・サービス戦略

4. 海外事業展開

5. 企業文化・風土改革

- **活況な半導体関連産業**に加え、中国、欧州では自動車の**EV化が加速**している。特に**中国がEV市場の主戦場**になると予測されている。
- **半導体パッケージ基板検査装置、車載FPC向け検査装置及び露光装置**をラインナップに持つ当社にとっても大きなチャンス。

アジアへの展開

- 2022年 中国・蘇州に営業・サービス拠点を置き、中国国内におけるビジネスを強化。
- 2024年 東アジアでの生産検討。リードタイム短縮、生産コスト低減及び現地エンジニアの育成。

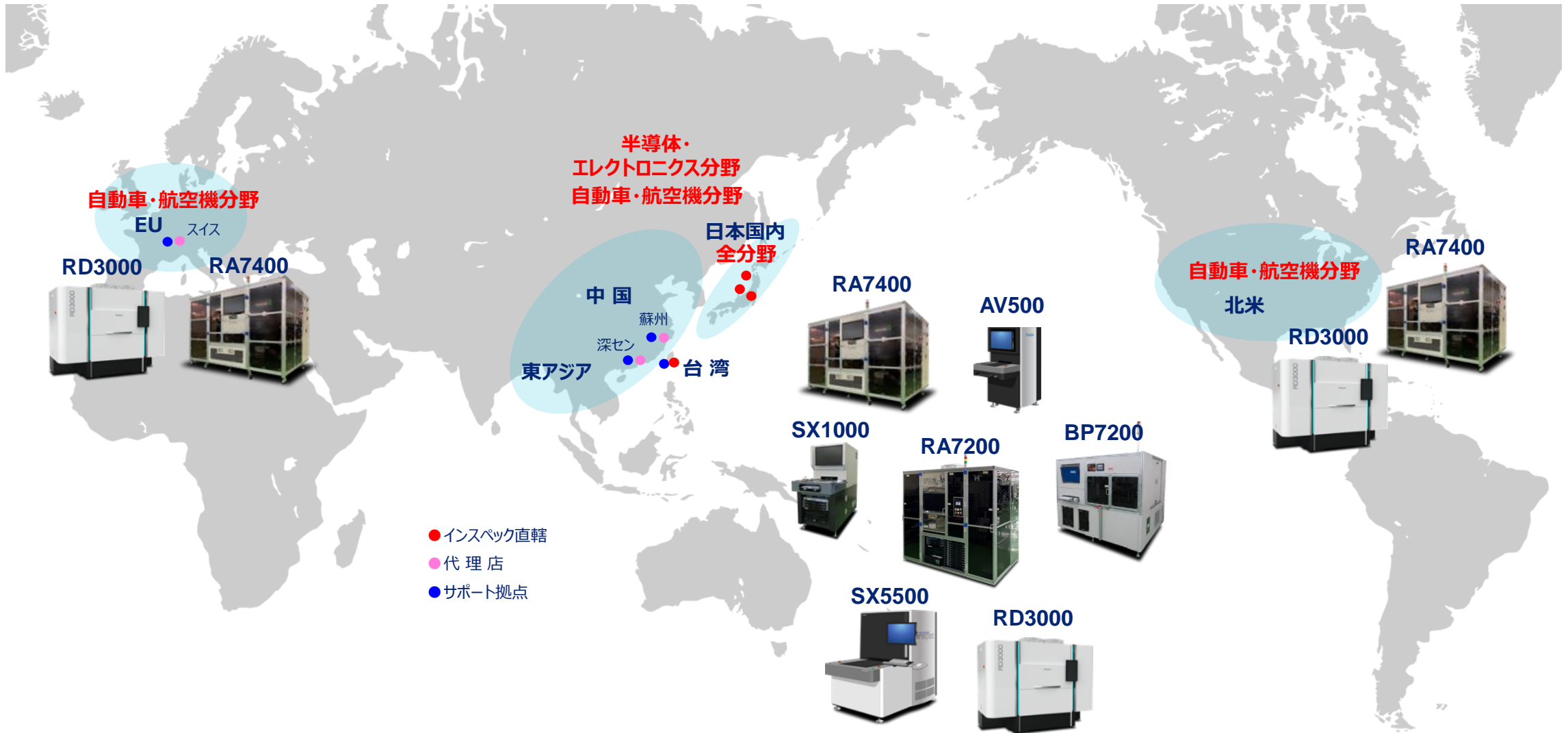
欧米への展開

- 2022年 現地代理店による販売網の構築。
現地エンジニアの育成。

【課題】

- 中国におけるCovid-19のまん延、渡航制限
- ロシアによるウクライナ危機で半導体、自動車関連のサプライチェーンに大きな影響

事業エリアの拡大





1. 中期経営計画について

2. 売上・利益計画

3. 製品・サービス戦略

4. 海外事業展開

5. 企業文化・風土改革

インスペック風土改革

社員の一人ひとりが社会の繁栄と発展にどのように貢献できるのか？

その中でどのように自分が輝けるのか？

あらためて自分たちの存在意義を見つめ直すため、インスペックは風土改革に取り組みます。

パーパス経営へ インスペックの存在意義を再定義し、その実現を目指します～2022年12月

- 全社員でパーパスを見出し、理解を深め、パーパス経営を実践します。2023年1月～
- 「働きがい認定企業(GPTW)」を目指します。2023年1月～

私たちインスペックは自分たちの存在意義を見つめ直し、 社会の繁栄と発展に貢献してまいります。



- 車載FPC検査装置、露光装置の販売拡大による車両軽量化及びサプライチェーン問題解消への貢献
- 製品含有化学物質規制への対応及び製品のバージョンアップによる廃棄物の削減
- DXの加速による業務効率改善、収益アップ
- 人事評価制度、報酬制度の改定
- 地域災害ボランティアへの登録

挑戦こそが未来への唯一の扉

インスペックは自社が持つ技術・ノウハウを駆使して
まだ見ぬ明日へチャレンジし続けます。

画像処理技術

レーザー技術

光学センシング技術

精密機械技術

メカトロニクス技術



Appendix

- 用語集
- 本資料取り扱いのご注意

AOI (Automated Optical Inspection)	自動光学検査装置、パターン検査装置。
AVI (Automated Final Visual Inspection)	自動最終外観検査装置。
FPC (Flexible Printed Circuits)	フレキシブルプリント回路基板、フレキシブルプリント配線板と呼ばれ、絶縁性を持った薄く柔軟なベースフィルムと、銅箔等の導電性金属を貼り合わせた基材に電気回路を形成した基板。
LDI,DI (レーザー直描露光機)	プリント基板制作において基板上に塗布された感光材にレーザー光で直接描画する露光装置。
SDGs	Sustainable Development Goals (持続可能な開発目標)。国連加盟193か国が2016年から2030年の15年間で達成するために掲げた17項目の目標。
パーパス (経営)	自社の存在意義を明確化し、社会に与える価値を示す。パーパスを軸にして企業活動を行い、社会に対して貢献していくことを「パーパス経営」と言う。
半導体パッケージ基板	ICチップと外部を接続し、電源供給と電気信号の入出力を可能にする。またICチップに形成される非常に微細な回路を、衝撃やほこり、湿気など、外部環境から保護する役割を果たす。
ベリファイ装置	Verify : 実証する、確認するという意味。検査装置本体で欠陥 (不良品) として判断された基板でも、実際はごみの付着による誤検出などで、ごみを取り除けば良品になることから、検査プロセスの中で、検査装置での検査した後、ベリファイ装置を使用する機会が多い。
ライン/スペース (L/S)	読み方は「ライン・アンド・スペース」。回路基板上の配線幅と配線間のスペース幅のこと。
レーザービア	レーザービームを基板に照射し、異なる層の回路同士を接続するために開けられる穴。
ロールtoロール	電子デバイスを効率よく量産する手法の一つ。ロール状に巻いた長さ数十～数百メートル、巾数十センチメートル程度のフィルム状の材料に基板の回路パターンを印刷し、封止膜などと張り合わせてから再びロールに巻き取る。従来方式では個別に切り離された基板を使うため、ある工程から次の工程に個々の基板を搬送する手間が掛かる。

本資料のお取り扱い上のご注意

本資料は当社をご理解いただくために作成されたもので、当社への投資勧誘を目的としたものではありません。

本資料を作成するに当たっては、正確性を期すために慎重に行っておりますが、完全性を保証するものではありません。本資料中の情報によって生じた障害や損害については、当社は一切責任を負いません。

本資料中の業績予想ならびに将来予測は、本資料作成時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため事業環境の変化等の様々な要因により、実際の業績は言及又は記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となることをご承知おきください。